关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的承诺函

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份的方式收购杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）、Lee Heng Lee、井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的杭州长奕科技有限公司97.6687%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人作为上市公司的董事、高级管理人员承诺如下：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、本人承诺，如公司未来拟实施股权激励计划，则该股权激励计划的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺函出具日至本次交易完成前，若中国证监会、证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

7、若本人违反上述承诺并给上市公司或其投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或其投资者的补偿责任。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会、证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此承诺。

（以下无正文）

(本页无正文,为《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的承诺函》之签署页)

董事签名:

赵 轶

钟锋浩

孙 峰

韩 笑

陈江华

杨征帆

于燮康

黄 英

李庆峰

非董事高级管理人员签名:

唐永娟

年 月 日